

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-graficzna-geforce-rtx-5060-windforce-max-oc-8g-gddr7-3dp-hdmi-p-372610.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Karta graficzna GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G GDDR7 3DP/HDMI

Cena brutto	<b>1 668,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 356,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KGGBAN506388009</b>
Kod producenta	<b>GV-N5060WF2MAX OC-8GD</b>
Kod EAN	<b>4719331356699</b>
Taktowanie pamięci	<b>28</b>
Szyna pamięci	<b>128-bitowa</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR7</b>
Porty wideo	<b>3 x DisplayPort</b>
Obsługiwane standardy	<b>OpenGL 4.6</b>
Chłodzenie	<b>Aktywne</b>
Chipset	<b>GeForce RTX 5060</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja obsługi</b>
Wymiary	<b>40 x 116 x 199 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 Rekomendowany zasilacz: 550 W Złącza zasilania: 8-pin Liczba podłączonych monitorów: 4</b>
Liczba wentylatorów (karty graf.)	<b>2</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Rdzenie CUDA (tylko Nvidia - przy AMD usunąć)	<b>3840</b>
Wersja	<b>Box</b>
Złącze karty graf.	<b>PCI-E 16x ver. 5.0</b>
Wielkość pamięci VRAM	<b>8</b>
Taktowanie rdzenia	<b>2512</b>

### Opis produktu

#### GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G

- Zasilana przez architekturę NVIDIA Blackwell i technologię DLSS 4

- Napędzana przez GeForce RTX 5060
- Zintegrowana z 8 GB pamięci GDDR7 i 128-bitowym interfejsem
- System chłodzenia WINDFORCE: wentylator Hawk; żel termoprzewodzący klasy serwerowej
- Wzmocniona konstrukcja

System chłodzenia WINDFORCE zapewnia wyjątkową wydajność termiczną dzięki połączeniu nowoczesnych technologii. Obejmuje on żel termoprzewodzący klasy serwerowej, innowacyjne wentylatory Hawk z naprzemiennym kierunkiem obrotu, kompozytowe miedziane ciepłowody, miedzianą płytke, wentylatory 3D Active oraz chłodzenie przez otwartą konstrukcję radiatora.

#### **WENTYLATOR HAWK**

Wentylator Hawk cechuje się unikalną konstrukcją łopatek, inspirowaną aerodynamiką skrzydeł orła. Taka budowa zmniejsza opór powietrza i poziom hałasu, zapewniając do 53,6% większe ciśnienie powietrza oraz 12,5% większy przepływ powietrza bez pogorszenia akustyki.

#### **NAPRZEMIENNE OBROTY (ALTERNATE SPINNING)**

Zmniejsza turbulencje między sąsiadującymi wentylatorami i zwiększa ciśnienie przepływu powietrza.

#### **WENTYLATOR 3D ACTIVE**

Wentylator 3D Active oferuje półpasywne chłodzenie wentylatory pozostają wyłączone przy niskim obciążeniu GPU lub w mniej wymagających grach.

#### **ŻEL TERMOPRZEWODZĄCY KLASY SERWEROWEJ**

W celu zwiększenia jakości i niezawodności produktu zastosowaliśmy żel termoprzewodzący klasy serwerowej do chłodzenia kluczowych komponentów, takich jak VRAM i MOSFET-y. Ten wysoce elastyczny, nienakapalny żel zapewnia optymalny kontakt z nierówną powierzchnią i skutecznie opiera się odkształceniom podczas transportu i długotrwałego użytkowania w przeciwieństwie do tradycyjnych padów termicznych.

#### **MIEDZIANA PŁYTA I KOMPOZYTOWE CIEPŁOWODY**

Miedziana płytka bezpośrednio styka się z GPU, a połączone z nią kompozytowe miedziane ciepłowody szybko odprowadzają ciepło z **GPU i VRAM do radiatora**.

#### **CHŁODZENIE PRZEZ OTWARTĄ KONSTRUKCJĘ (SCREEN COOLING)**

Wydłużony radiator pozwala powietrzu swobodnie przepływać, co zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła.

#### **ULTRA DURABLE**

- **ULTRA COOLING** - MOSFET-y o niższym oporze przełączania RDS(on) zostały zaprojektowane tak, by szybciej przewodzić prąd przy bardzo niskich temperaturach.
- **NISKIE STRATY ENERGII** - Metalowe dławiki utrzymują energię znacznie dłużej niż zwykłe rdzenie żelazne przy wysokich częstotliwościach, skutecznie redukując straty rdzenia i zakłócenia EMI.
- **DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ** - Kondensatory stałe o niższym ESR zapewniają lepsze przewodnictwo elektryczne, co przekłada się na wyższą wydajność systemu i dłuższą żywotność.

#### **PRZYJAZNA KONSTRUKCJA PCB**

W pełni zautomatyzowany proces produkcji zapewnia najwyższą jakość płytek PCB i eliminuje ostre krawędzie lutów, często spotykane na tradycyjnych płytkach. Taka konstrukcja chroni Twoje dłonie przed skaleczeniem i zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu komponentów podczas składania komputera.